

敝豐企業股份有限公司

公司簡報

www.efm.com.tw



敝豐企業股份有限公司

ECLAT FOREVER MACHINERY CO.,LTD.

114.10.20

簡報內容

- 一、公司簡介及經營理念
- 二、營業概況
- 三、經營實績
- 四、研發成果
- 五、未來展望

一、公司簡介及經營理念

1.1 公司簡介

1.2 公司沿革

1.3 集團轉投資架構

1.4 公司組織架構

1.5 董事結構

1.6 經營團隊

1.7 經營理念

1.1 公司簡介

- ◎ 敝豐企業成立於1994年7月，是印刷電路板(PCB)、液晶顯示器(LCD)及觸控面板(Touch Panel)等相關製程生產設備之專業製造廠。
- ◎ 為了更全面的服務客戶，敝豐昆山廠於2012年5月正式完成建置，並陸續投產設備製造，能夠就近反應客戶端的問題，提供更迅速的售後服務支援。
- ◎ 為了提高設備質量及技術競爭力，公司除了擴大研發部門之規模並投資興建潔淨室，且投入TFT-LCD、OLED、柔性顯示器、醫療X光感光元件、5G、高效能運算之高階載板FCBGA及晶圓級封裝等製程設備之研發。

1.1 公司簡介

1. 台灣廠位於桃園市八德區
2. 建廠完成: 2000年1月
3. 廠房面積: 8,200 m²
850 m²無塵室(class10,000)
2,500 m²潔淨室



1. 大陸廠位於江蘇省昆山市
2. 建廠完成: 2012年 5月(第一期)
2020年12月(第二期)
3. 土地面積: 26,666.7m²
4. 廠房面積: 22,418.56 m²



1.2 公司沿革

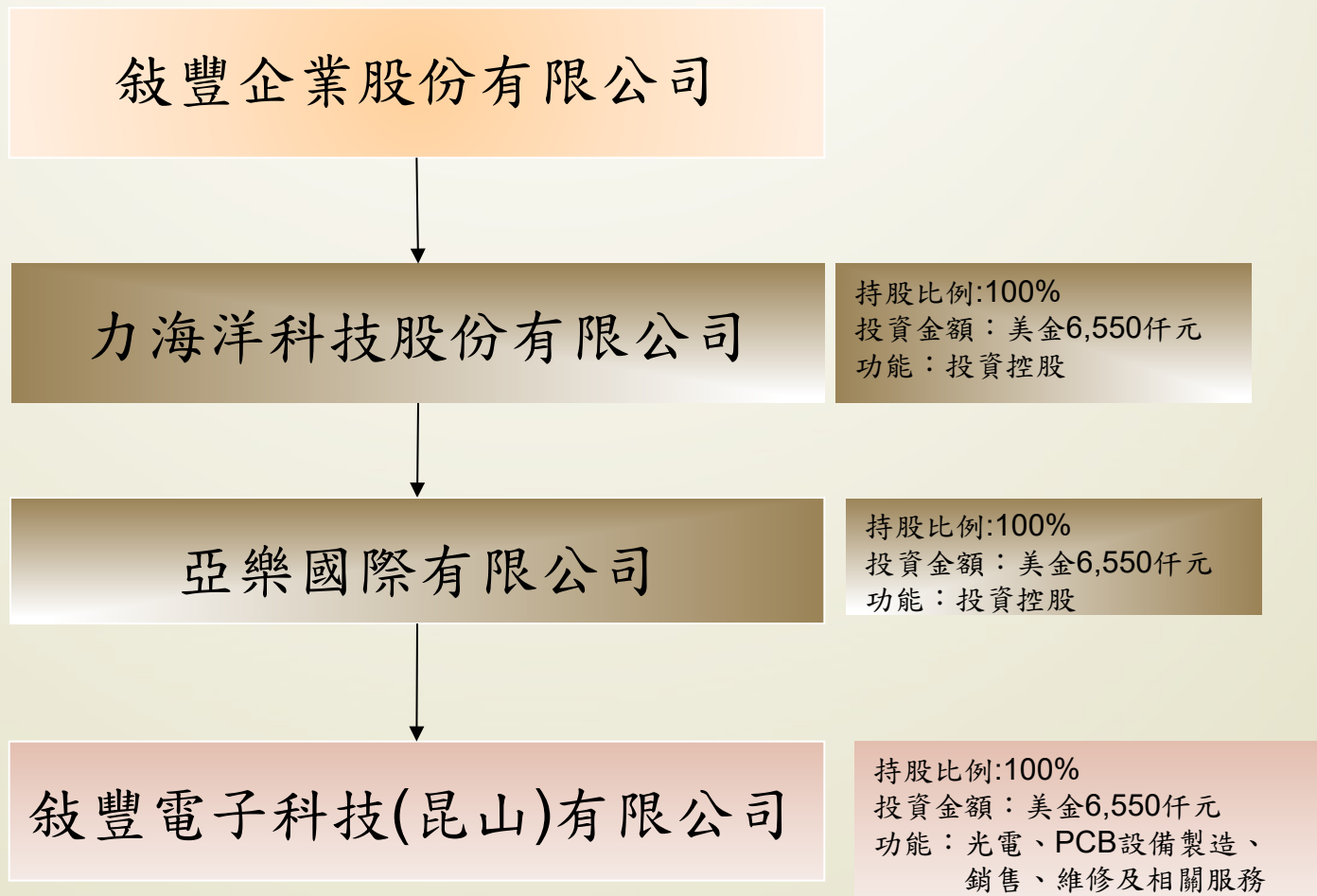
1. 公司重要記事：

- * 1994.07 敝豐企業(股)公司成立
- * 2000.01 敝豐新廠(現址)落成啟用
- * 2000.07 取得 ISO-9001 品質認證
- * 2002.11 取得 ISO-9001 2000 年版品質認證
- * 2005.06 股票公開發行
- * 2012.05 大陸昆山新廠落成
- * 2012.09 登錄興櫃(3485)
- * 2015.08 合併台灣歐特瑪科技股份有限公司
- * 2017.11 認證通過 ISO 9001-2015 版
- * 2020.12 大陸昆山廠二期廠房完工。

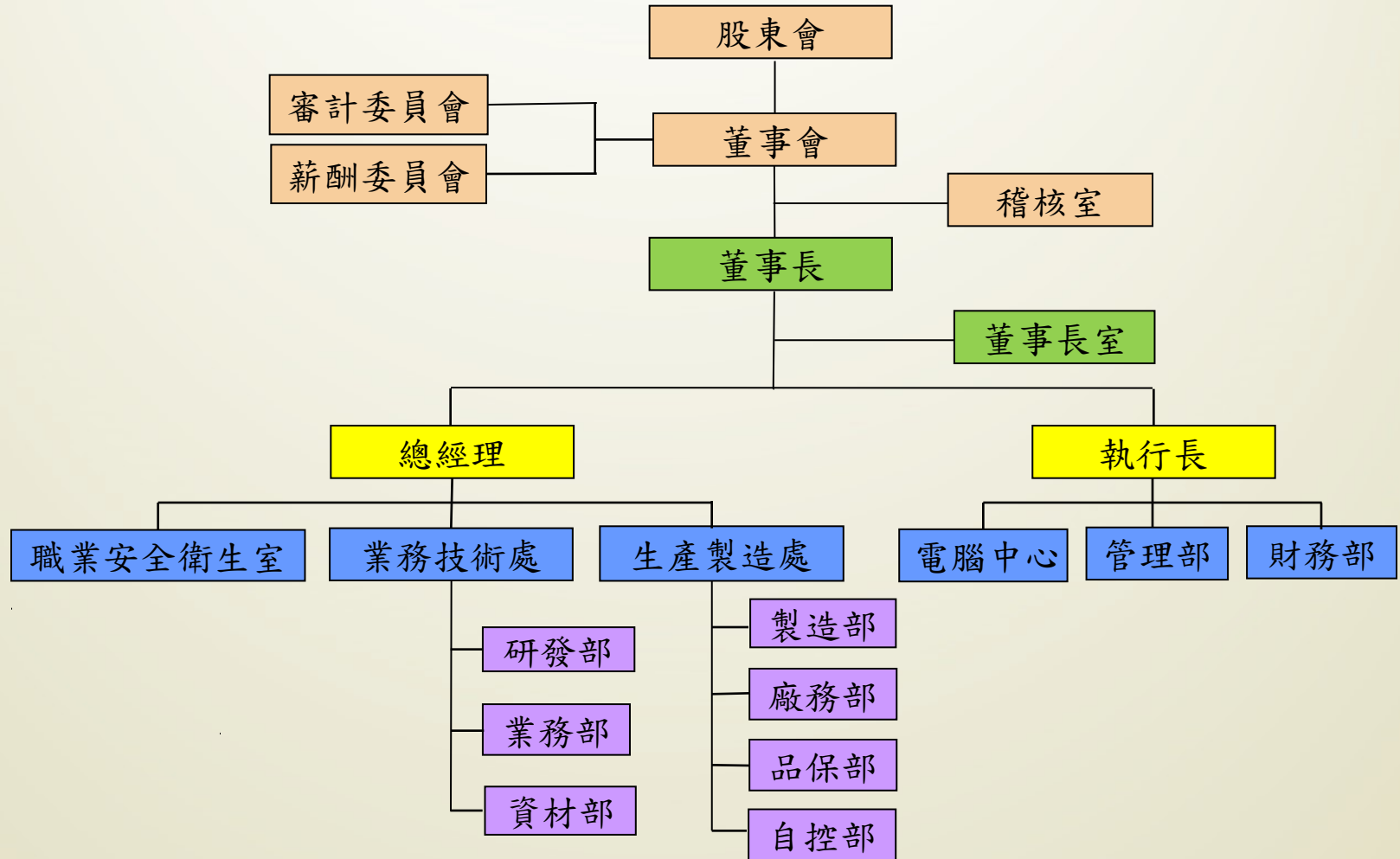
2. 資本額 : 341,919 仟元

3. 員工人數 : 99 人(114.9)

1.3 集團轉投資架構



1.4 公司組織架構



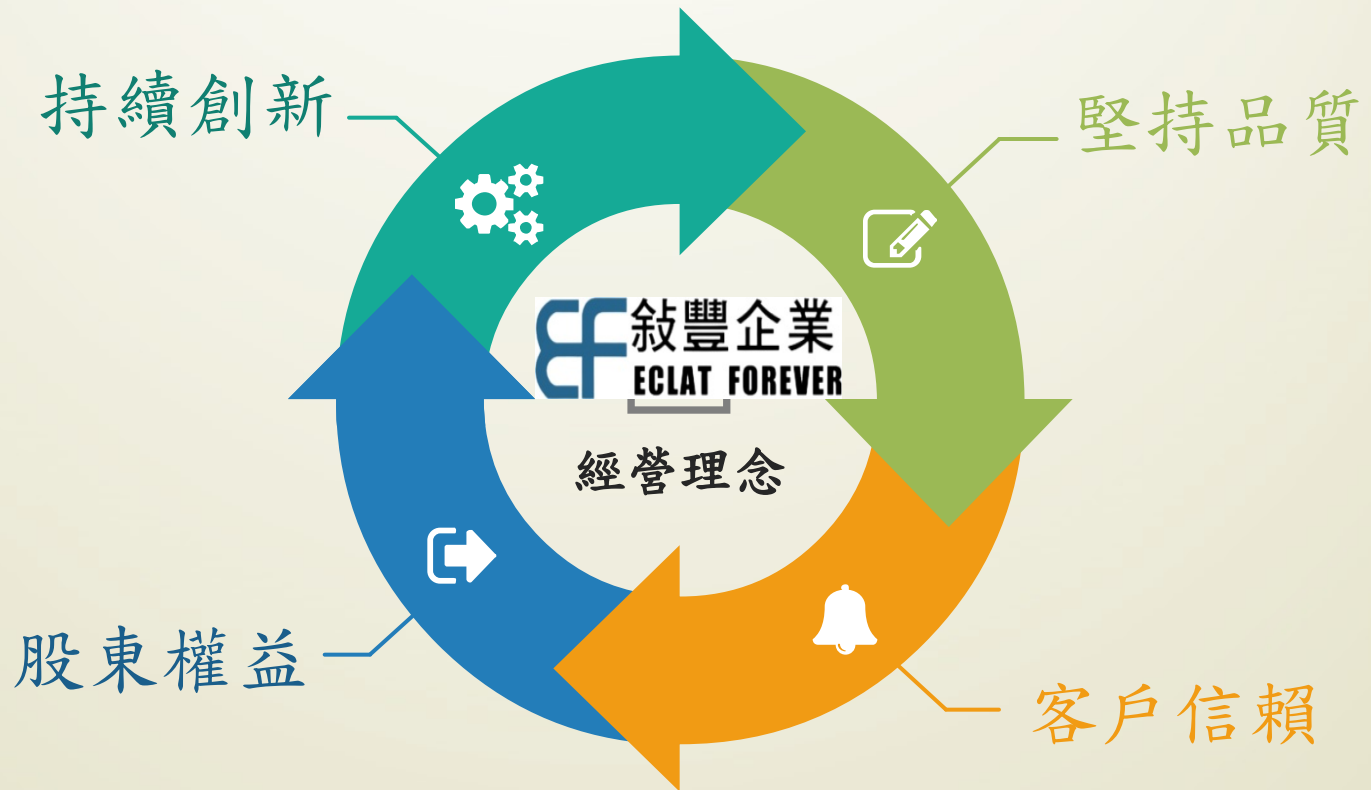
1.5 董事結構

職稱	姓名	學／經歷	114年9月30日持股	
			持有股數	持股比率
董事長	周政均	Fort Hays State University企管系畢業 艾瑪投資(股)公司董事長 兆暘投資(股)公司董事 敘豐企業(股)公司董事長特助	1,853,312	5.42%
董事	珮瑜投資股份有限公司 代表人：詹珮琳	南華大學 企管系畢業 昱銘公司財務科長	1,570,757	4.59%
董事	帛億股份有限公司 代表人：陳怡君	輔仁大學織品行銷研究所畢業 摩曼頓採購，湯米席爾菲格採購，威暘整合 行銷執行秘書，萬事達遠東採購，台灣彪馬 業務助理	2,886,598	8.44%
獨立董事	劉東杰	美國曼卡托大學 藝術碩士 輔仁大學經濟系畢業 台灣中小企銀31年經驗曾任國際部經理	-	-
獨立董事	周 斌	逢甲大學交通管理系畢業 台灣中小企銀35年經驗 曾任洛杉磯分行經理/中壢分行經理	47,101	0.14%
獨立董事	張裕倉	健行科技大學電機工程系畢業 財團法人台灣綠色生產力基金會 部門經理 財團法人中技社 組長	-	-
獨立董事	陳韻如	文化大學法律系財經組畢業 翊捷法律事務所主持律師	-	-

1.6 經營團隊

職 稱	姓 名	就任日期	主要經(學)歷
執行長	周政均	99.11.14	Fort Hays State University企管系畢業 鈺豐企業(股)公司董事長特助 鈺豐企業(股)公司執行副總
總經理	杜松穎	97.03.03	南亞工專機械科畢 台灣歐特瑪科技股份有限公司副總經理
生產製造處 協理	鄭材治	109.02.03	交通大學管理學院高階主管管理碩士 中華映管股份有限公司公司總處長
業務部 副處長	高國洲	112.04.06	近畿大學經營學科畢 台灣三壑電氣股份有限公司主任 鈺豐企業股份有限公司業務部經理
製造部 副處長	黃勝衍	111.05.09	龍華工專電機科畢 捷嘉自動化股份有限公司負責人 鈺豐企業股份有限公司有限公司自控部經理
研發部 副處長	羅德強	93.05.17	元智大學製技系畢 台灣歐特瑪科技股份有限公司研發部經理
研發部 經理	郭先立	93.02.27	元智大學機械工程學系碩士 登泰電路機械股份有限公司
管理部經理兼 公司治理主管	陳玉靜	85.02.02	清雲科技大學企管系畢 中華映管股份有限公司
資材部 經理	黃小華	97.10.01	南亞工專機械科畢 台灣歐特瑪科技股份有限公司資材副理 九營機械股份有限公司
自控部 經理	崔醒民	105.08.01	健行工專電機科畢 宇崎科技股份有限公司自控部經理
財務部經理	蕭雅娟	114.07.07	中原大學會計研究所畢 勤業眾信聯合會計師事務所 審計經理 樂鞞生活創意股份有限公司 財會經理

1.7 經營理念



二、營業概況

- 2.1 主要產品及應用領域
- 2.2 產業現況
- 2.3 產品中下游關聯性

2.1 主要產品及應用領域

我們的產品
Our products

高階載板
FCBGA設備
FCBGA EQPT

智能
自動化設備
Automated Logistics

www.efm.com.tw



鉸豐企業股份有限公司
ECLAT FOREVER MACHINERY CO.,LTD.

顯示器
生產設備
Display Production EQPT.

離型取下
及貼合設備
MLO&Laminating EQPT.

2.2 產業現況

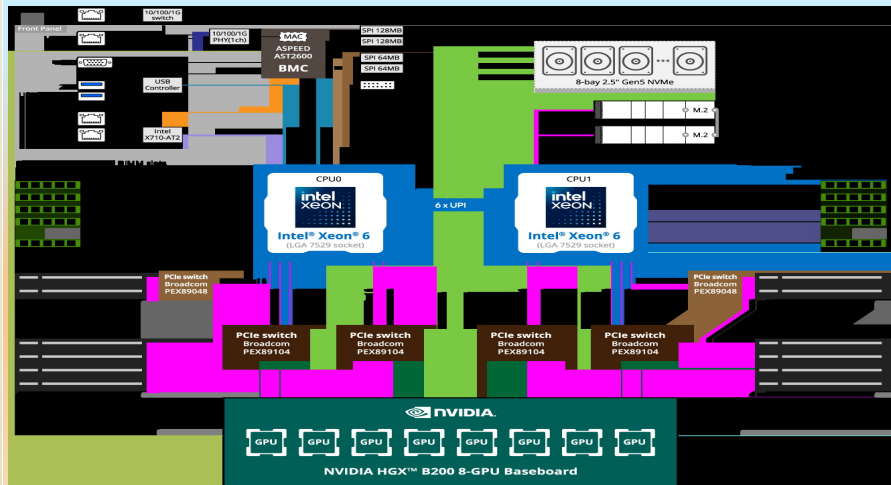
高階IC覆晶載板FCBGA

◎IC載板龍頭大廠表示，高階ABF載板明年可能出現供不應求的熱況，已有客戶擔心未來2-3年高階ABF載板供應吃緊，正在洽談中期計畫，在接下來的2-3年每年將持續投資150至200億元在AI載板與系統板（OAM）相關高階技術。目前具備製造高階ABF載板能力的供應商相當有限，僅有日本一家大廠與國內龍頭大廠，高階IC覆晶載板FCBGA生產製造跟晶圓代工產業類似在全世界是非常集中的產業。

新聞來源：MoneyDJ新聞

◎媒體報導，Ibiden經營層表示，儘管PC及通用伺服器用IC載板訂單略低於原先預期，但生成式AI伺服器用IC載板訂單遠超預期。

新聞來源：MoneyDJ新聞



圖片來源：技嘉官網

· IC基板三大封裝型式

型式	結構	特性
球陣列封裝 (BGA)		以錫球陣列替代傳統金屬導線架作為接腳，所以面積大且能傳輸的電路也較多。
晶片級封裝 (CSP)		單一晶片封裝之技術，封裝尺寸與IC本身尺寸大小幾乎相同
覆晶 (FC)		將晶片正面翻覆，以凸塊直接連接基板之封裝

圖片來源：MoneyDJ理財網

2.3 產業上、中、下游關聯性

零組件供應商

電子設備業

面板、光電
半導體廠

上游

中游

下游

原 材 料	PVC板材、不鏽鋼板材 不鏽鋼棒、鈦棒、碳棒 電料
加 工 件	PVC / 金屬 CNC加工 車床、銑床加工 電射、電解、電鍍加工 射出成型塑膠焊接、氬 焊
部 品	泵浦、馬達 各式閥類 PLC模組、人機介面 過濾元件 流量計、壓力計

平面顯示器製程設備
觸控面板製程設備
載板製程設備
太陽光電製程設備
半導體製程設備

平面顯示器
TN / STN / TFT LCD
Color Filter、OLED
觸控面板
投射式玻璃/導電薄膜電容
載板
LSP、CSP、BGA、
FCBGA
太陽光電
Wafer Base、Thin Flim
半導體
有機Interposer

三、經營實績

3.1 產品別銷售比重

3.2 主要銷貨客戶群

3.3 主要客戶區域別

3.4 主要供應商

3.5 112~114年第二季營運情形

3.6 111~113年度股利分配情形

3.1 產品別銷售比重

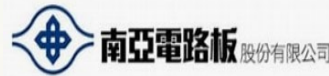
單位：新台幣仟元

產品別	112年度		113年度		114年1-6月	
	金額	%	金額	%	金額	%
設備收入	571,571	93.92	574,957	94.11	264,851	92.75
其他(註)	37,000	6.08	35,510	5.89	20,698	7.25
合 計	608,571	100.00	610,467	100.00	285,549	100.00

註：其他係指維修、零組件及勞務銷售收入。

3.2 主要銷貨客戶群

Unimicron
欣興電子



景碩科技



SCC
深南电路



CORISE



INNOLUX
群創光電

MICRO
ENGINEERING INC.

Futaba
富泰電子股份有限公司



ND
New Vision Display

TRULY® 信利
信利光電股份有限公司



KOE
JDI Group



CFOC
廣聚光電股份有限公司
GENSHING OPTONICS CORPORATION



莱宝高科
LAIBAO HI-TECH

TIANMA



AUO



TPK

NAKAN
ナカンテクノ株式会社

伯恩光学

3.3 主要客戶區域別

項目	112年度	113年度	114年 前二季
內銷比重	41%	80%	61%
外銷比重	59%	20%	39%

3.4 主要供應商

 MITSUBISHI PLASTICS

 C.I. TAKIRON

 **bürkert**
FLUID CONTROL SYSTEMS

 中日噴霧股份有限公司

 **FESTO**

 **KEYENCE**

 **Oriental motor**

威幅系統有限公司 **WAVz Solutions**

 **SMC**

 **DELTA**

 **緯虹精密科技有限公司**
WEIHON Precision Technology Co., Ltd.

 **OMRON**

 **MITSUBISHI ELECTRIC** | TAIWAN
Changes for the Better

 **精台鐳射精密股份有限公司**
JING TAI LASER PRECISION CO.,LTD

 **GRUNDFOS**

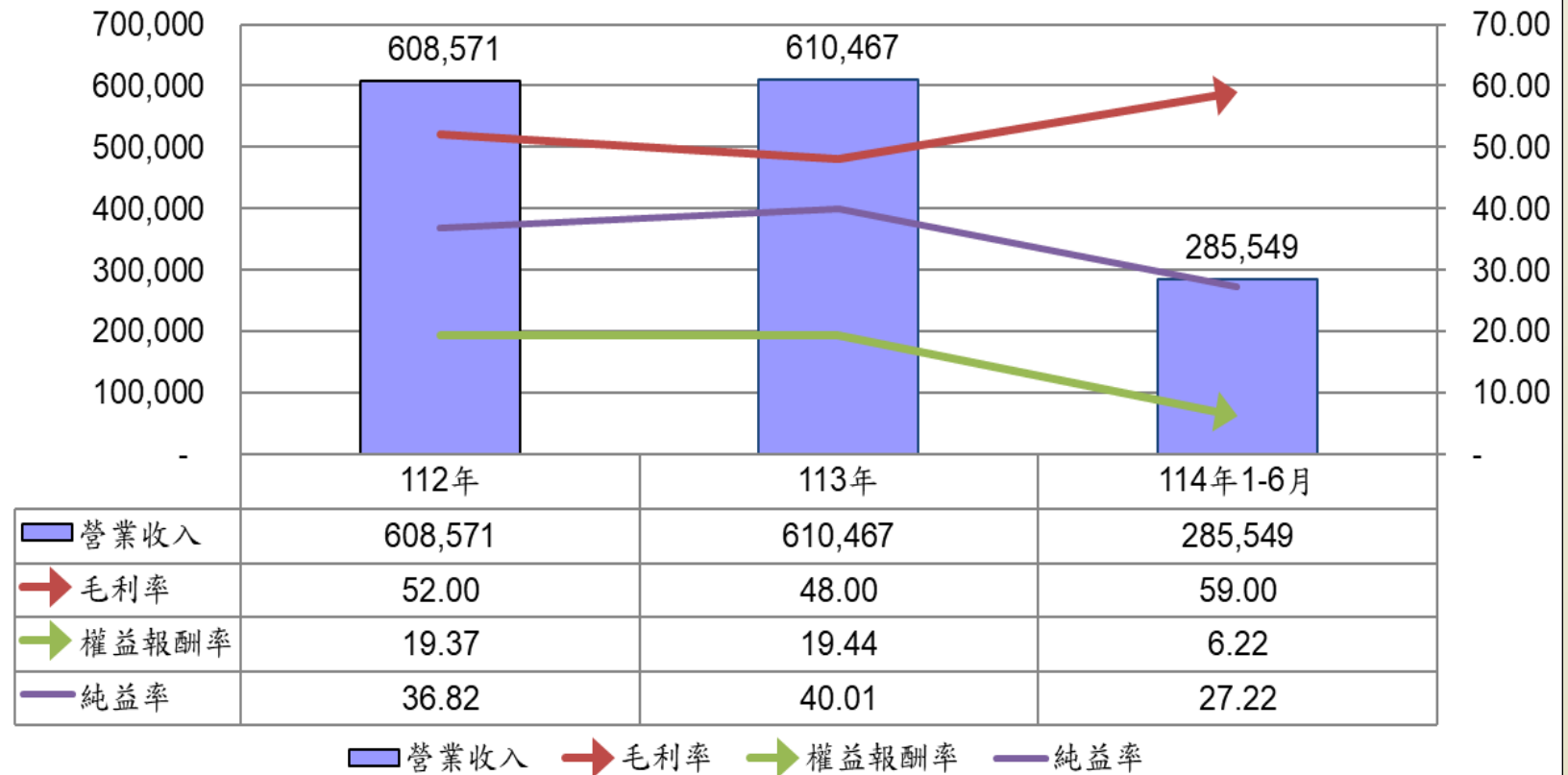
 **士林電機**
Shihlin Electric

 **名超企業股份有限公司**
MAING CHAU ENTERPRISE CO.,LTD.

 **IWAKI**
The Heart of Industry

3.5 112~114年第二季營運情形

單位：新台幣仟元



資料來源：經會計師查核簽證或核閱之財務報告

3.6 111~113年度股利分配情形

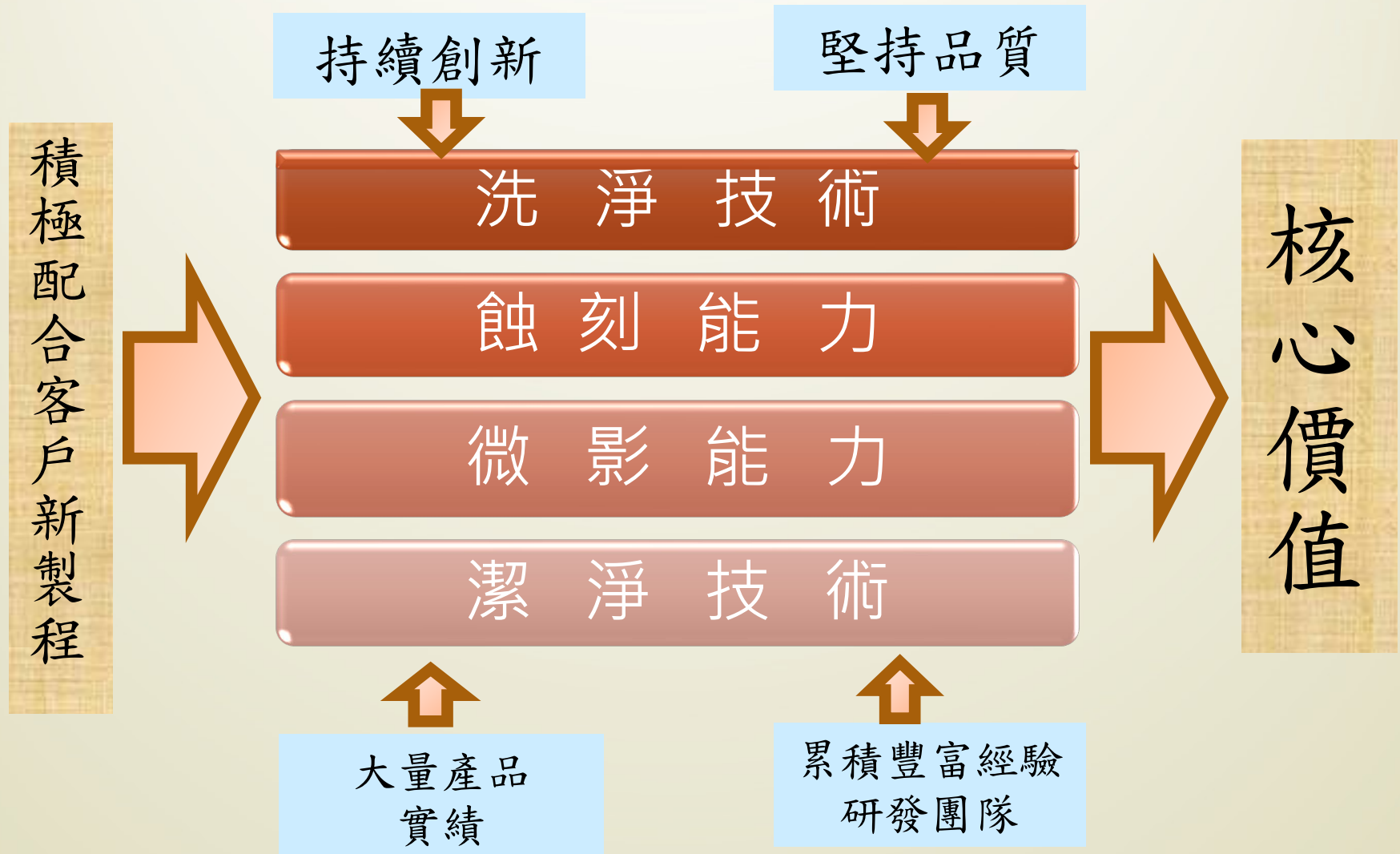
項目 \ 年度	最近三年度綜合損益表		
	111年	112年	113年
每股淨值-分配前	34.78	37.64	38.30
每股淨值-分配後	29.71	33.14	32.80
每股盈餘 (元)	7.74	7.11	7.14
每股現金股利	5.07	4.50	5.50
每股股票股利	-	0.70	-
現金殖利率	9.73%	5.68%	8.08%
股票殖利率	-	6.54%	-

四、研發成果

- 4.1 研發概況
- 4.2 研發成果

4.1 研發概況

核心技術(微細線路)



4.2 研發成果

最近五年度重要研發成果及說明

年度	產 品	功 能 (用途說明)
110	低Profile表面超粗化蝕刻機 (8401)客戶端量產驗證完成	針對高頻IC之覆晶載板，為降低因線路表面Profile產生之高頻訊號波形異常。故需低Profile表面超粗化蝕刻機之新製程設備。
	ABF高階IC覆晶載板FCBGA非接觸式 (Contact Free) 垂直式框架顯影機	由於ABF高階IC覆晶載板起始增層板較薄，在水平式濕製程設備無法完全達到非接觸式 (Contact Free) 生產而開發。
111	ABF高階IC覆晶載板FCBGA振動過濾排膜剝膜機	針對高頻IC之覆晶載板，因應細線路光阻剝離後之排膜。採高頻低振幅振動方式排出細微光阻。增強排膜功能。
112	垂直式框架腔體自動潔淨系統	吹烘乾段在生產過程中容易在腔體內部沾附particle,因此在機台非生產時段利用旋轉噴頭噴洗吹烘乾段內腔體,藉此提升設備潔淨度,提高產品良率
113	玻璃夾持框架機構	TGV玻璃厚度在0.1mm(100 μ m)時，夾持、噴灑冷熱風乾燥時，非常容易破裂，經開發夾持座對應適合硬度之夾點，已能在經過相關製程而不破裂。
	單片垂直浸泡設備	垂直單片製程設備(VSP)為因應載板增層層數越來越高，面積越來越大且新線路構裝發展出特殊製程需求之設備。
114	VSP-GLicap垂直浸泡式表面化學鍵結處理機	由於線路趨向更微細化，線路表面化學咬蝕後利用表面粗糙度再壓合ABF，但在高時脈時造成波型雜訊，故新製程改採線路表面代學鍵結再壓合ABF，改善訊號波型

4.2 研發成果

專利狀況

公司產品的銷售區域大部分為台灣，大陸、日本、韓國，故公司專利佈局皆以台灣、大陸、日本、韓國為主。而專利申請內容是以關鍵技術上下連結機構加上相類似關連型態所組成專利範圍。

114年9月底(有效專利)

地區	台灣	中國	日本	韓國	美國	合計
專利件數	14件	15件	10件	5件	2件	46件

五、未來展望

短期計劃

- 積極開拓利基型產品新客戶
- 以產品差異化及優質化達成市場區隔(智能自動化，製程整合)

中期計劃

- 提升研發技術及能量投入下一代高階生產設備
- 開發完整VSP產品線，增加產品製程應用領域

長期計劃

- 藉由策略聯盟、國際技術合作掌握市場先機
- 透過產官學研(客戶、科專、工研院)合作機制獲取創新競爭力

謝 謝

THE END